

MIRDC-103-A207

MEMS製程技術與 設備發展動向

作者：陳仲宜

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇三年十二月

目錄

■ 摘要	1
■ 前言	2
■ 微機電系統製程技術分析	2
■ MNMS 系統製程設備發展動向.....	7
■ 應用展望.....	12



MEMS 製程技術與設備發展動向

金屬中心 MII 產業分析師 陳仲宜

摘要：

在微機電系統(Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS)領域中，目前的主流關鍵技術為矽基微加工技術，其以矽晶圓(Wafer)為基板，主要包括體型矽基微加工技術及面型矽基微加工技術，主要是提供懸浮的或者是可動的機械元件，例如樑、板、齒輪、連桿等。由於機械的複雜特性，單一的製程平台很難滿足微機電系統各種不同的要求。因此，多元化的微機械加工製程平台，是一個很有可能的發展趨勢。隨著半導體製程及超精密加工等技術與設備不斷精進，未來將陸續有更具特色，關鍵元件更完備及整合能力更強的製程平台可望被開發出來，帶動微機電系統的發展得以加速地向前邁進。援此，本文擬探討微機電系統製程技術及設備之發展現況與應用展望。

《MEMS 製程技術與設備發展動向》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>